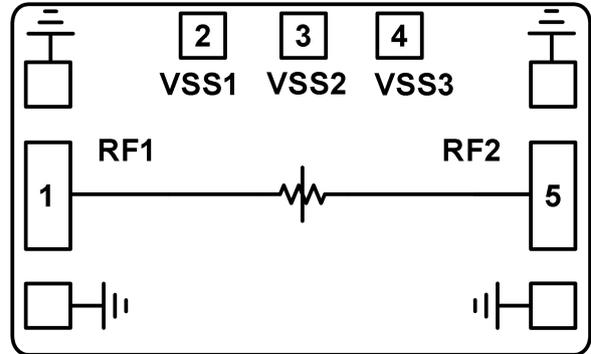




主要特点

- 插入损耗: 4.5 dB
- 衰减补偿范围: 6 dB
- 温度补偿范围: -55~ +125°C
- 输入输出回波损耗: 15 dB
- 控制电压: -5 V
- 芯片尺寸: 1.0×1.0 × 0.1 mm³

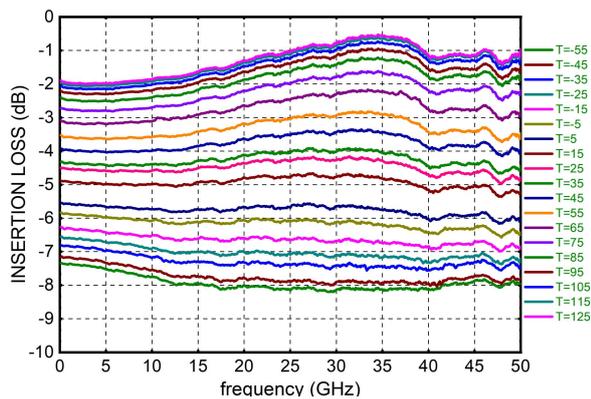
功能框图



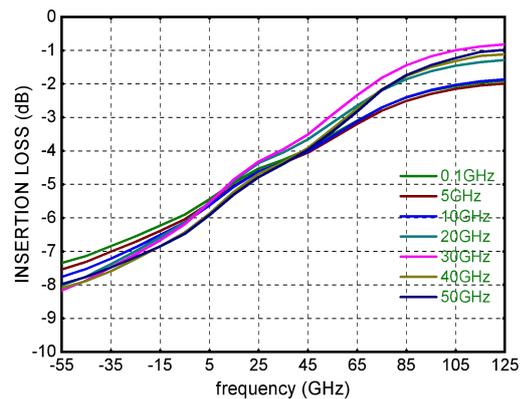
性能指标 (T = +25 °C, VSS1 = -5 V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC~50			GHz
插入损耗		4.5		dB
衰减补偿范围		6		dB
温度补偿范围	-55~+125			°C
回波损耗		15		dB
输入功率 1dB 压缩点		16		dBm

插入损耗 VS 频率

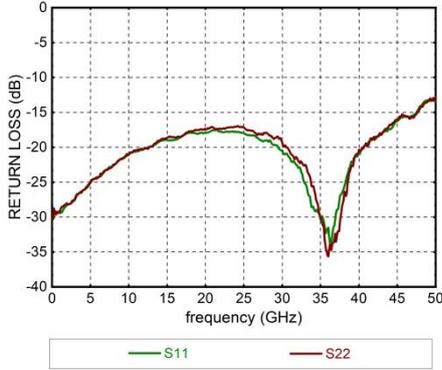


插入损耗 VS 温度

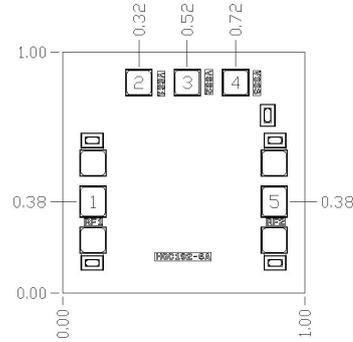




回波损耗



物理参数

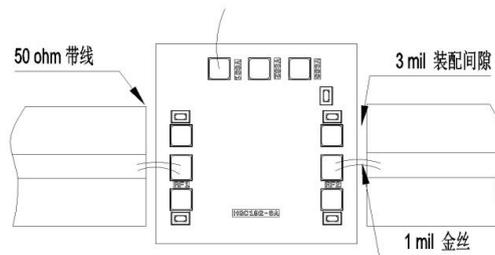


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 5	RF1, RF2	该焊盘是射频输入、输出端口, 如果 RF 电位不是 0V, 需要外部加入隔直电容
2	VSS1	该焊盘是电源输入端口, 需要外接 100 pF 和 1 nF 旁路电容
3, 4	VSS2, VSS3	悬空
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

推荐装配图

单位: mm



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100um
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100um²
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN; 厚度: 0.6um

极限参数

1. 电源电压: -6V
2. 射频输入功率: +27 dBm
3. 储存温度: -65~+150°C
4. 工作温度: -55~+125°C